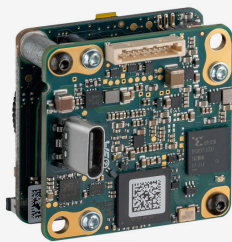
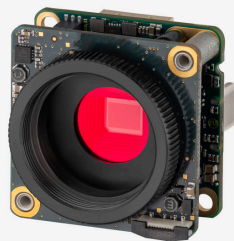


■ 量産中

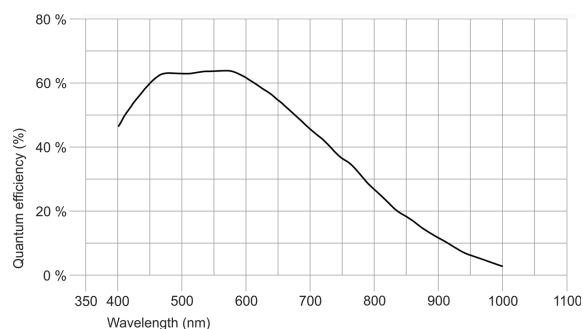
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS モノクロ
シャッター	グローバルシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	1.6 MP
有効画素数	1.58 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	1456 x 1088 ピクセル
アスペクト比	4:3
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/2.9"
撮像面積	4.996 mm x 3.747 mm
光学センサーの対角	6.25 mm 1/2.9"
画素サイズ	3.45 μm
CRA (主光線角)	0 °
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX273LLR-C
ゲイン (マスター/RGB)	25.4x/-
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	256 / 2
AOI 画像の高さ、ステップ幅	1 / 1
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	2 / 1
ビニング水平	増加したフレームレート
ビニング垂直	増加したフレームレート
ビニング手法	水平: 加算 / 垂直: 加算
ビニング係数	2x2
デシメーション(サブサンプリング) 水平	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング) 垂直	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング) 手法	M/C 自動
デシメーション(サブサンプリング) 係数	2x2



モデル

フレームレートフリーランモード	235 fps
フレームレートトリガー（連続）	244 fps
フレームレートトリガー（最大）	244 fps
露出時間（最小～最大）	0.022 ms - 2000 ms
長時間露出（最大）	30606 ms
消費電力	0.8 W - 1.8 W
画像メモリ	-

環境条件

PCB バージョンについては、該当するドキュメントのヒントを参照してください。

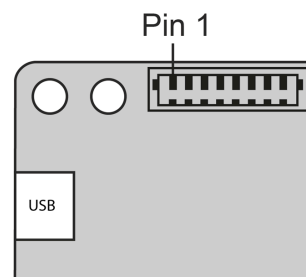
動作時の許容デバイス温度	0 ° C - 55 ° C / 32 ° F - 131 ° F
保管時の許容デバイス温度	-20 ° C - 80 ° C / -4 ° F - 176 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % - 80 %

コネクタ

インターフェースコネクタ	USB Type-C
I/O コネクタ	Wuerth 製 10 ピンコネクタ（WR-WTB 1.00 mm）
電源	USB ケーブル

ピン割り当て I/O コネクタ

1	電圧出力 5 V、最大. 400 mA
2	接地（GND）
3	汎用入出力（GPIO）2、3.3 V - Line 3
4	汎用入出力（GPIO）1、3.3 V - Line 2
5	I2C クロック信号 - USB3 Vision ファームウェア 3.2 以上が必要
6	I2C データ信号 - USB3 Vision ファームウェア 3.2 以上が必要
7	オプトカブラなしのトリガー入力 3.3 V - Line 0
8	オプトカブラなしのフラッシュ出力 3.3 V - Line 1
9	接地（GND）
10	電圧出力 3.3 V



設計

レンズマウント	CS- / C-マウントレンズ
保護構造	-
外形寸法	36.0 mm x 36.0 mm x 26.0 mm
重量	20 g
ハウジング素材	-

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。

このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得

Freerun	✓
Software trigger	✓
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	✓
Long exposure	✓
Line scan	-

U3-3044LE-M-GL-VU-AF Rev. 1. 2 (1008139)

フラッシュ	Flashing	✓
	PWM flashing	-
画像調整	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y
統合画像処理	Pixel formats	Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	2x2
	Binning (FPGA)	-
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
その他	Chunks	-
	Sequencer	-
	Events	-
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	2.20